

































2022年 秋季学期 Dennard Scaling  $R = \rho \frac{l}{A}$   $C = Q/V = \varepsilon A/d$ TABLE I SCALING RESULTS FOR CIRCUIT PERFORMANCE Device or Circuit Parameter Scaling Factor Device dimension  $t_{ox}$ , L, W  $1/\kappa$ Doping concentration  $N_a$ Voltage V $1/\kappa$ Current I $1/\kappa$ Capacitance  $\epsilon A/t$  $1/\kappa$ Delay time/circuit VC/I  $1/\kappa$ Power dissipation/circuit VI  $1/\kappa^2$ Power density VI/A 晶体管尺寸缩小了30% (0.7倍),掺杂浓度提高1.4倍 (1/0.7), 面积A减少50%; 电路延迟减少了30% (0.7倍) ----工作频率提高约40% (1.4倍) 电压降低了30%,能量降低了65%,功率降低了50% 在每一代技术中,晶体管密度增加一倍,电路速度提高40%,功耗保持不变 wang hong@tsinghua.edu.cn

18











